



2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2023年2月14日

上場会社名 株式会社フェローテックホールディングス 上場取引所 東
 コード番号 6890 URL http://www.ferrotec.co.jp
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 賀 賢漢
 問合せ先責任者 (役職名) 代表取締役副社長 (氏名) 山村 丈 TEL 03-3281-8186
 四半期報告書提出予定日 2023年2月14日 配当支払開始予定日 -
 四半期決算補足説明資料作成の有無：無
 四半期決算説明会開催の有無：無

(百万円未満切捨)

1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年12月31日）

(1) 連結経営成績（累計）

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年3月期第3四半期	155,690	65.7	26,743	65.2	35,281	94.0	23,737	10.7
2022年3月期第3四半期	93,981	41.2	16,184	159.0	18,188	215.8	21,445	229.4

(注) 包括利益 2023年3月期第3四半期 49,459百万円 (69.5%) 2022年3月期第3四半期 29,186百万円 (319.4%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年3月期第3四半期	518.21	506.07
2022年3月期第3四半期	558.42	513.12

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
2023年3月期第3四半期	421,896	259,247	45.3	4,083.88
2022年3月期	264,772	160,957	49.5	2,940.93

(参考) 自己資本 2023年3月期第3四半期 191,321百万円 2022年3月期 131,022百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年3月期	-	23.00	-	27.00	50.00
2023年3月期	-	50.00	-	-	-
2023年3月期（予想）	-	-	-	50.00	100.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

2022年3月期第2四半期末配当金の内訳 普通配当 14円00銭 特別配当 9円00銭

2022年3月期期末配当金の内訳 普通配当 18円00銭 特別配当 9円00銭

3. 2023年3月期の連結業績予想（2022年4月1日～2023年3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	200,000	49.5	34,000	50.4	40,000	53.9	25,000	△6.2	542.73

（注）直前に公表されている業績予想からの修正の有無：有

※ 注記事項

（1）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無
新規 -社（社名）-、除外 -社（社名）-

（2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：有

（注）詳細は、添付資料8ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更：有
- ② ①以外の会計方針の変更：無
- ③ 会計上の見積りの変更：無
- ④ 修正再表示：無

（注）詳細は、添付資料8ページ「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記（3）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

（4）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	2023年3月期3Q	46,942,367株	2022年3月期	44,645,431株
② 期末自己株式数	2023年3月期3Q	94,269株	2022年3月期	93,897株
③ 期中平均株式数（四半期累計）	2023年3月期3Q	45,806,551株	2022年3月期3Q	38,404,435株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	3
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	6
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(会計方針の変更)	8
(セグメント情報等)	9

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における経営環境については、欧米諸国では景気回復が見られた一方、インフレが継続していることから、その抑制のため政策金利引き上げが続いています。日本でも景気回復基調となり、夏の新型コロナウイルス感染拡大が収まったのち、外国人入国制限の緩和によるインバウンド消費回復も期待されましたが、11月以降に再び感染拡大に転じ、経済正常化へ影を落としております。また、年末アナウンスされた日銀の金融緩和修正策は、為替や株価の大きな変動要因となりました。中国は厳格なゼロコロナ政策継続の影響から景気が下押しされていたなか、11月後半から一転して厳格な感染防止政策を解除したのち、新型コロナウイルスの感染者が大幅に増加しました。その結果、経済活動への悪影響が出ており、正常化にはやや時間がかかりそうな見込みです。また、ロシアのウクライナ侵攻は継続しており、燃料や資材価格に引続き影響を与えております。

為替相場は、大きく円安方向に進みましたが、年末に円高の方向に転換しました。

当社グループの属するエレクトロニクス産業では、リモートワークやWEB会議の普及もあり、データセンターや通信向けの需要は高水準で推移しております。半導体製造装置の需要も高水準に推移しましたが、メモリなどの製品では在庫調整局面となりつつあります。また、10月半ばに米国による中国への半導体技術輸出規制の強化が発表されたことによる半導体需要への影響が注目されております。

このような事業環境のなか、当社グループの半導体等装置関連事業では、製造装置向けの真空部品や半導体製造プロセスに使用される各種マテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）など販売が引続き好調であり、前年同期比で大きく売上を伸ばしました。

電子デバイス事業では、サーモモジュールは通信機器向け中心に売上を伸ばしました。パワー半導体用基板は、中国でのEV（電気自動車）向け販売が強く、同セグメントの売上の伸びを押し上げました。

なお、経常利益は為替差益が69億円発生し、前年同期比で大きく増加しました。一方、前年同期は持分法適用会社の第三者割当増資に伴う93億円の持分変動利益（特別利益）を計上したため、相対的に当第3四半期連結累計期間は特別利益が減少しております。

この結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は155,690百万円（前年同期比65.7%増）、営業利益は26,743百万円（前年同期比65.2%増）、経常利益は35,281百万円（前年同期比94.0%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は23,737百万円（前年同期比10.7%増）となりました。

当第3四半期連結累計期間のセグメントの経営成績は、以下のとおりです。

なお、第1四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。以下の前年同期比較については、変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。詳細は、「2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 (セグメント情報等)」に記載しております。

(半導体等装置関連事業)

当該事業の主な製品は、真空シール及び各種製造装置向け金属加工製品、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC製品、シリコンパーツ、装置部品洗浄、石英坩堝などです。

真空シールおよび各種製造装置向け金属加工製品は半導体製造装置向けを中心に売上を伸ばしました。半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品（石英製品・セラミックス製品・シリコンパーツ等）は、堅調な半導体製造装置需要に伴い、各製品とも大きく売上を伸ばしました。また、石英坩堝や半導体製造装置向け部品洗浄サービスも順調に売上を伸ばしました。生産能力面でも中国常山地区で実施した第2期増産投資が完了し、7月より生産開始したことで、金属加工、石英製品の売上増に貢献しました。

この結果、当該事業の売上高は99,154百万円（前年同期比58.3%増）、営業利益は18,161百万円（前年同期比62.8%増）となりました。

(電子デバイス事業)

当該事業の主な製品は、サーモモジュール、パワー半導体用基板、磁性流体、センサなどです。

主力のサーモモジュールは、5G用の移動通信システム機器向けを中心に高水準な販売を維持しました。パワー半導体用基板は、AMB基板の中国のEV車載向け販売が強い伸びとなっていることに加え、広範な用途に使用されるDCB基板も好調を維持しました。また、第2四半期連結会計期間より連結化した株式会社大泉製作所のセンサの売上、利益も当セグメントに含まれております。

この結果、当該事業の売上高は38,159百万円（前年同期比99.5%増）、営業利益は8,553百万円（前年同期比82.2%増）となりました。

(その他)

「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。

第2四半期連結会計期間より連結化した東洋刃物株式会社の売上、利益が、当第3四半期連結会計期間よりソーブレードに含まれております。

この結果、当該事業の売上高は18,376百万円（前年同期比50.6%増）、営業利益は668百万円（前年同期比21.0%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

<資産>

当第3四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末と比べ157,124百万円増加し、421,896百万円となりました。これは主に現金及び預金63,518百万円、受取手形、売掛金及び契約資産19,113百万円、有形固定資産49,057百万円の増加によるものであります。

<負債>

当第3四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比べ58,833百万円増加し、162,648百万円となりました。これは主に転換社債型新株予約権付社債2,134百万円の減少があった一方、支払手形及び買掛金9,061百万円、短期借入金13,522百万円、長期借入金（1年内返済予定を含む）22,513百万円の増加によるものであります。

<純資産>

当第3四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比べ98,290百万円増加し、259,247百万円となりました。これは主に資本剰余金21,868百万円、利益剰余金20,374百万円、非支配株主持分37,993百万円の増加によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、2022年11月14日に公表いたしました通期の業績予想を修正しております。

なお、詳細につきましては、本日公表の「2023年3月期通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	52,579	116,098
受取手形、売掛金及び契約資産	41,797	60,911
商品及び製品	7,858	10,918
仕掛品	7,882	13,595
原材料及び貯蔵品	12,696	22,311
その他	11,110	7,666
貸倒引当金	△509	△714
流動資産合計	133,414	230,786
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	22,728	30,635
機械装置及び運搬具（純額）	25,122	36,894
工具、器具及び備品（純額）	5,324	6,435
土地	1,895	3,573
リース資産（純額）	4,040	12,143
建設仮勘定	24,972	43,459
有形固定資産合計	84,083	133,141
無形固定資産		
のれん	283	3,352
その他	1,713	3,028
無形固定資産合計	1,996	6,380
投資その他の資産		
関係会社株式	36,058	36,461
その他	9,842	15,825
貸倒引当金	△623	△698
投資その他の資産合計	45,277	51,588
固定資産合計	131,358	191,110
資産合計	264,772	421,896

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2022年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	26,702	35,764
電子記録債務	4,068	4,019
短期借入金	6,324	19,847
1年内償還予定の社債	2,658	4,723
1年内返済予定の長期借入金	5,843	11,928
未払法人税等	2,207	3,456
賞与引当金	1,556	3,048
その他	19,437	24,927
流動負債合計	68,800	107,714
固定負債		
社債	8,806	5,082
転換社債型新株予約権付社債	2,134	—
長期借入金	11,796	28,225
退職給付に係る負債	560	2,119
資産除去債務	213	320
その他	11,503	19,186
固定負債合計	35,014	54,933
負債合計	103,814	162,648
純資産の部		
株主資本		
資本金	28,210	29,329
資本剰余金	46,071	67,940
利益剰余金	43,317	63,691
自己株式	△87	△88
株主資本合計	117,511	160,872
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	406	267
為替換算調整勘定	13,128	30,167
退職給付に係る調整累計額	△23	14
その他の包括利益累計額合計	13,511	30,448
新株予約権	45	43
非支配株主持分	29,888	67,882
純資産合計	160,957	259,247
負債純資産合計	264,772	421,896

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

(四半期連結損益計算書)

(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
売上高	93,981	155,690
売上原価	59,359	101,316
売上総利益	34,622	54,373
販売費及び一般管理費	18,438	27,630
営業利益	16,184	26,743
営業外収益		
受取利息	129	527
補助金収入	537	2,063
為替差益	1,802	6,979
その他	665	645
営業外収益合計	3,135	10,215
営業外費用		
支払利息	546	827
持分法による投資損失	281	186
その他	303	663
営業外費用合計	1,131	1,677
経常利益	18,188	35,281
特別利益		
固定資産売却益	22	—
持分変動利益	9,332	649
段階取得に係る差益	—	204
特別利益合計	9,354	853
特別損失		
固定資産処分損	129	86
事業撤退損	924	—
災害による損失	—	325
段階取得に係る差損	—	702
その他	128	—
特別損失合計	1,182	1,115
税金等調整前四半期純利益	26,359	35,019
法人税等	4,240	8,161
四半期純利益	22,119	26,857
非支配株主に帰属する四半期純利益	673	3,120
親会社株主に帰属する四半期純利益	21,445	23,737

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
四半期純利益	22,119	26,857
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	138	△135
為替換算調整勘定	5,146	18,453
退職給付に係る調整額	14	89
持分法適用会社に対する持分相当額	1,768	4,193
その他の包括利益合計	7,067	22,601
四半期包括利益	29,186	49,459
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	27,038	40,674
非支配株主に係る四半期包括利益	2,148	8,784

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

当第3四半期連結累計期間において、連結子会社である江蘇富樂華半導体科技股份有限公司及び寧夏盾源聚芯半導体科技股份有限公司は第三者割当増資を実施したため、資本剰余金が16,080百万円増加しました。

連結子会社である安徽富樂徳科技發展股份有限公司は、2022年12月30日に深圳証券取引所創業板市場に上場し、公募による新株式の発行を行ったため、資本剰余金が4,434百万円増加しました。

また、転換社債型新株予約権付社債の転換により、資本金が1,067百万円、資本剰余金が1,067百万円それぞれ増加しました。

これらの結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金が29,329百万円、資本剰余金が67,940百万円となっております。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

(税金費用の計算)

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。また、見積実効税率を使用できない場合は、税引前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等を含めて表示しております。

(会計方針の変更)

(時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用)

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を第1四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自2021年4月1日至2021年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	62,645	19,131	81,776	12,204	93,981	—	93,981
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	62,645	19,131	81,776	12,204	93,981	—	93,981
セグメント利益	11,158	4,694	15,852	552	16,405	△221	16,184

- (注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。
- 2 セグメント利益の調整額△221百万円には、セグメント間取引の消去7百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用213百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- 3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(固定資産に係る重要な減損損失)

「半導体等装置関連事業」セグメントにおいて、減損損失256百万円を計上しており、特別損失の事業撤退損に含めて表示しております。

II 当第3四半期連結累計期間(自2022年4月1日至2022年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
	半導体等 装置関連事業	電子デバ イス事業	計				
売上高							
(1)外部顧客への 売上高	99,154	38,159	137,314	18,376	155,690	—	155,690
(2)セグメント間 の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—	—	—
計	99,154	38,159	137,314	18,376	155,690	—	155,690
セグメント利益	18,161	8,553	26,714	668	27,383	△639	26,743

- (注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーブレード、工作機械、表面処理、太陽電池用シリコン製品等の事業を含んでおります。
- 2 セグメント利益の調整額△639百万円には、セグメント間取引の消去1百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用637百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
- 3 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

2. 報告セグメントの変更等に関する事項

第1四半期連結会計期間より、従来「その他」に含めていた米国子会社における受託製造事業及び成膜装置事業は、経営管理区分の見直しにより「半導体等装置関連事業」の区分に含めて記載する方法に変更しております。

なお、前第3四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成したものを記載しております。